



# GLPOLY XK-S100 双组分导热胶

双组份有机硅导热胶

产品简介	产品特性	典型应用
XK-S100 双组分热间隙填料可在室温或高温下固化,具有触变性,具有高性能和优异的柔软性。它在低压缩力下变形,可适应各种不同的间隙厚度。它是具有高形变或微小间隙公差有要求的易碎部件的完美解决方案,兼容自动点胶工艺,取代导热硅胶片。	导热系数10.0 W/m. K 室温或加热固化 100% 固体,无固化副产物。 通过加热快速固化成型,是精密部件和低应力应用的理想选 择。	计算机及周边产品 导热、减震、热源与散热器间应用 任何发热半导体、散热器等领域应用 动力电池、汽车电子、光模块、通讯设施

en e			
	XK-S100	测试法	单位
颜色/A 组分	白色	目视	
颜色/B 组分	灰色	目视	
特点	软凝胶		
密度	3.3±0.1	ASTM D792	g/cm3
固化前性能			
A:B	1:1		
混合粘度 @ 25℃	430±50	ASTM D2196	Pa.s
贮存时间 @ <35℃ 湿度 40%-70%	6 个月		
固化后性能			
颜色	灰色	目视	
操作时间	125 min/25℃	目视	min
硬度	Shore 00 50±5	ASTM D2240	Shore 00
拉伸强度	$0.05\!\pm\!0.03$	ASTM D412	Мра

伸长率	>10	ASTM D412	%
服役温度	-60~200	ASTM G 166	°C
硅氧烷 D3~D20	<0.05	GC-MS	%
	电性能		
击穿强度	>8	ASTM D149	KV/mm
体积电阻	>10 <sup>12</sup>	ASTM D257	Ohm-cm
介电常数	8	ASTM D150	(1KHz)
阻燃性	V-0	UL94	
	导热性能		
导热系数	10.0	ASTM D5470	W/m*K
比热容	1	ASTM E1269	J/g-K
贮存时间	6		月份



# 操作程序和建议:

- 1. AB 胶的比例为 1:1,两剂 AB 胶应混合均匀。
- 2. 选项及工具:自动点胶机或手动上胶枪。
- 3. 固化时间与成品的点胶厚度有关。以 1.0mm 厚度为例:

固化温度 ℃	固化时间
25	6-24 hr
50	2~6hr
80	60~120min
100	40~60min
150	20~40 min

## 注意事项:

如果接触面接触到硫、磷、氮和有机金属盐等物质,会阻止表面硬化,轻则会抵制表面和接触面的硬化,重则会导致永久完全不硬化。

#### 环境方面:

除了要求正确的混合比例外、而在使用纸杯、塑料杯等搅拌容器时,由于容器内壁含有油蜡,塑料内增塑剂的渗入,烘烤时会造成容器内壁的油蜡脱落。因此,请在使用前清洁并擦干机器,特别是要避免与烘箱内的环氧树脂和清漆接触的可能性。上述物质,请先进行测试。

## 存储方式:

- 1. 贮存方式:可贮存6个月,混合前室温应低于35度,湿度40%-70%。
- 2. AB 组份在混合后应一次用完,不得保留继续使用。

#### 包装:

4 种标准包装版本如下:

第1版: 25+25ml AB组份,6层\*10个,共60个,

标准纸箱尺寸 37.2\*30.8\*22.5cm。

第2版: 200+200ml AB组份, 2层6个, 共12个, 标准纸箱尺寸51.5\*38.5\*13.5cm。

第3版: 20L+20L桶包装 第4版: 200L+200L桶包装



# 特别声明:

以上所有陈述,技术信息和建议均基于本公司认为可靠的测试或经验。 鉴于配方、工艺、时间、条件等的不同,许多不可控因素都可能影响产品在特定应用中的使用和性能,因此用户应做评估并根据自己的生产情况进行调整,我司不作出任何承诺。我们强烈建议您进行自己的测试试验,以确认我们产品的适用性。敝司有权对自己的产品进行改进升级,其产品有任何改动,按技术状态管理程序提前通知。

除非另有明确约定,否则对技术数据表中的信息或有关产品的任何其他书面或口头建议不承担任何责任。

